

NXP, LFPAK56 패키지의 차량용 파워 MOSFET 출시

광범위한 차량 애플리케이션용 업계 최대 포트폴리오의 파워-SO8 MOSFET

2013년 3월 6일 - NXP 반도체(NASDAQ: NXPI)는 오늘, 차량용으로 인증받은 54 가지 새로운 MOSFET 제품을 LFPAK56 패키지로 출시한다고 밝혔다. 이는 현재 판매되는 파워-SO8 MOSFET 제품 중 최대 포트폴리오이다. 업계 선도의 성능과 신뢰성을 제공하는 NXP의 LFPAK56 MOSFET 제품들은 DPAK과 비교시 면적이 최대 55% 절감되어 전반적인 비용 절감에 큰 도움을 준다. LFPAK56 MOSFET 제품들은 다양한 차량용 애플리케이션에 최적의 제품이며, 특히 파워트레인, 차체 및 보안, 새시 및 안전성과 관련한 애플리케이션에 적합하다.

NXP 반도체의 전 세계 제품 마케팅 매니저인 제이미 다이어(Jamie Dyer)는“LFPAK56의 뛰어난 성능과 내열 성능이 작은 면적에서 구현됨으로써 높은 신뢰성이 필요한 차량용 애플리케이션에 이상적인 제품’이라며,“NXP의 입증된 통합 구리 클립 기술력과 광범위한 MOSFET 제품 포트폴리오로, 설계자들이 가장 선호하는 제품이 됐다”고 밝혔다.

NXP의 LFPAK56 파워 MOSFET 제품들은 30V, 40V, 60V, 80V, 100V에서 작동되며, 모든 전압에서 뛰어난 RDS(on) 성능과 전류 처리 성능을 제공한다 :

- [BUK9Y3R0-40E](#): 40V 3.0 mΩ의 낮은 RDS(on)와 100A에 이르는 고전류 처리 성능으로, 좌석 조절, 파워윈도, 와이퍼, 펌프, 팬과 같은 모터로 구동되는 애플리케이션에 이상적이다.
- [BUK9Y59-60E](#): 60V 59 mΩ의 RDS(on)로, 직접 분사 방식인 GDI(gasoline direct injection)와 DDI(diesel direct injection)와 같은 엔진 관리 시스템에 이상적이다. 이 시스템은 통상 뛰어난 견고성과 작은 크기로 인해 매우 많은 부품을 필요로 한다.
- [BUK9Y38-100E](#): 100V 38 mΩ의 RDS(on)로, 매우 낮은 패키지 인덕턴스(inductance)와 작은 크기로 인해 차량용 LED 애플리케이션에 이상적이다.

LFPAK56: 구리 클립 장점

QFN의 마이크로 리드(micro-lead)는 균열이나 오염을 유발할 수 있는 이동을 막기 위해 완전히 봉해진 반면, LFPAK의 갈매기 날개 모양의 리드(gull-wing lead)는 구부러지거나 휘어질 수 있는 PCB 특성상 열 팽창과 기계적 변형이 가능하다. 통합 구리 클립은 낮은 전기적 저항과 낮은 열 저항, 낮은 인덕턴스 및 높은 신뢰성 또한 제공한다. NXP의 다른 트렌치 6 차량용 MOSFET과 같이 새로운 LFPAK56 MOSFET은 AEC-Q101 인증을 통과했고 175°C에서 1,600시간 이상의 수명을 가짐으로써 Q101의 기준을 훨씬 능가할 뿐 아니라 매우 낮은 PPM 수준을 제공한다.

관련 링크

NXP의 차량용 파워 MOSFETs LFPAK56 패키지: <http://www.nxp.com/lfpak56Auto>